

新製品

R-jet[®]

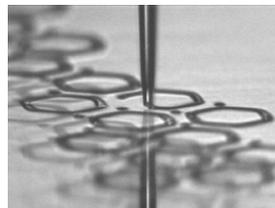
ツインエアー式 高精細ディスペンサー

Twin Pneumatic High-Resolution Liquid Dispensing System
with Top & Side View Optics

当社特許技術のリアルタイム・トップ&サイドビュー光学系搭載

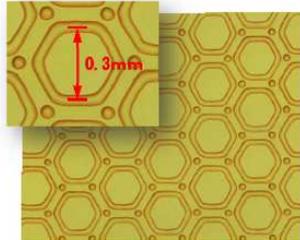
0201超小型電子部品製造工程.....各種接着剤の極微量塗布
 水晶発振子等の電極部の微小接着等.....導電性接着剤
 微細パターンニング、スクリーン印刷の断線リペア.....Ag,Cu(ナノ)ペースト
 電極形成、キャビティ内部の局所配線.....水晶発振子、MEMS、LED等
 LED製造工程の微量塗布.....蛍光粒子/酸化チタン液剤
 ハンダリペア、ハンダグリッドアレイ形成.....微量ハンダペースト滴下
 CMOS、CCD,PWRデバイス等.....封止材、絶縁材の微細な額縁塗布
 微小レンズ、ガラス部品の遮光材塗布・絞り形成...カーボンブラックインク
 既存のディスペンサーでお困りの方...超高性能ディスペンサーをご提供
 R&D用途.....様々な液体材料を目標位置へ正確に微小滴下が可能

小型軽量
量産工程へ最適



ドットとラインを一連動作で吐出可能

ダイナミック・ディスペンシング
モード・コントロール~DDMC



トップビュー搭載で
R&D、試作へも活用



RHB100C
ディスペンスユニット
(ベーシック・タイプ)



付属のコントローラ(各機種共通)

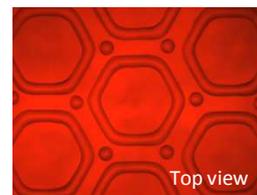
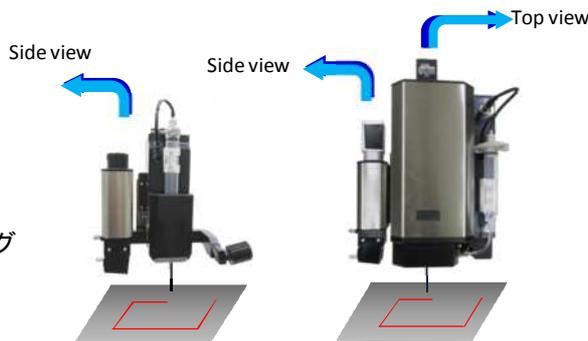
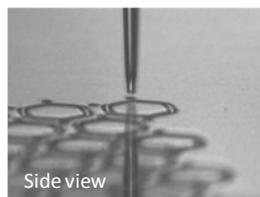
RHF100C
ディスペンスユニット
(マルチファンクション・タイプ
オプション: サイドビュー搭載)

エスコエレクトロニクス株式会社



Ver.1.20 Rev.150515

リアルタイム・トップビュー&サイドビュー光学系 (サイドビューはオプション)



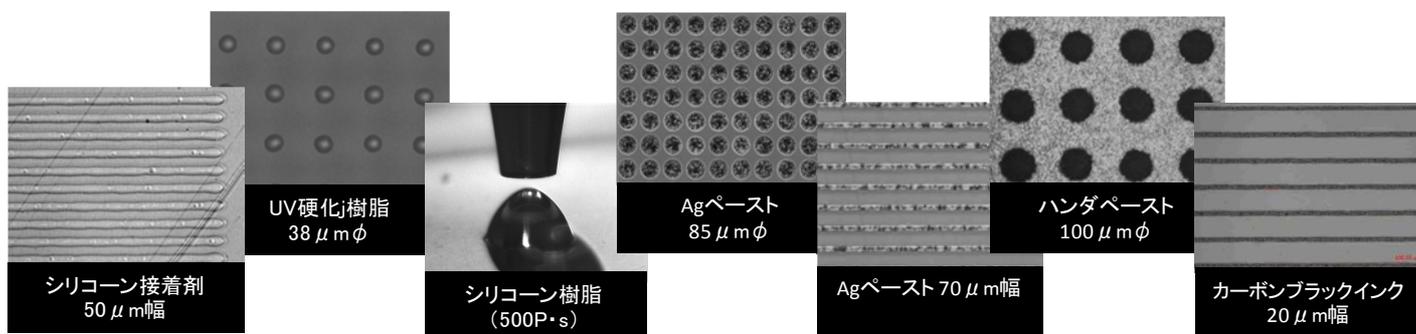
- 液流のリアルタイム・モニタリング
- 液流および着液状態の観察
- 基板の凹凸状態の確認
- ノズル先端とのギャップ確認

- オン・アクセス・アライメント
- 濡れのリアルタイム・モニタリング
- 塗布・描画後の簡易寸法測定
- 形状検査(要、画像処理ユニット)

ベーシック・タイプ

マルチファンクション・タイプ

描画・塗布アプリケーション例



シリコン接着剤
50 μm幅

UV硬化樹脂
38 μmφ

シリコン樹脂
(500P・s)

Agペースト
85 μmφ

Agペースト 70 μm幅

ハンダペースト
100 μmφ

カーボンブラックインク
20 μm幅

仕様は予告なく変更することがあります。最新の仕様に関しましては弊社までお問い合わせください。

仕様(抜粋) / 型名	RHB100C ディスペンスユニット(ベーシック)	RHF100C ディスペンスユニット (マルチファンクション)	RDX500-V RHF100C搭載 デスクトップ・システム
トップビュー	搭載不可	標準搭載	←
サイドビュー	オプション	←	←
セラミックノズル(内径μm)	25,40,70,100,150,200	←	←
レーザー変位計	搭載不可	オプション	←
トップビュー用カメラ	搭載不可	オプション	←
サイドビュー用カメラ	オプション	←	←
寸法(mm)・重量(kg)	W84 x H193 x D125 約2.9kg	W177 x H284 x D175.5 約7.3kg	W600 x D750 x H850 約130kg
X-Y-Zステージ(ロボット)	なし(別途ご用意ください)	なし(別途ご用意ください)	ストローク X-Y軸 50mm、Z軸 100mm
外観		 オプション サイドビュー搭載	

開発・製造・販売
エンジニアリングシステム株式会社
<http://www.engineeringsystem.co.jp>



〒399-0033 長野県松本市笹賀5652-83
 TEL.0263-26-1212・FAX.0263-26-1213
 E-mail:sales@engineeringsystem.co.jp